



KC ČIP.SI
SLOVENSKI KOMPETENČNI
CENTER ZA ČIPE

NOVIČNIK

Petek, 31. julij 2026

Pozdravljeni,

tudi v tem tednu smo za vas pripravili izbor novic in aktualnih vsebin, ki vam morda pridejo prav.

Dogodki v povezavi s KC Čip.si:

- **Konferenca MIDEM 2026 z delavnico na temo integrirane fotonike 28. – 30. september 2026, Fakulteta za elektrotehniko UL, Ljubljana**
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (**MIDEM**) organizira že 61. mednarodno konferenco s področja mikroelektronike, čipov, elektronskih sestavnih delov, senzorjev, gradnikov iz debelih in tankih plasti, naprednih materialov, fotovoltaike, optoelektronike in fotonike ter ostalih sorodnih področij.
V okviru konference bo 29. septembra 2026 v so-organizaciji [KC Čip.si](#) potekala delavnica na temo integrirane fotonike, tudi v povezavami z uporabo v kvantnih aplikacijah. Na delavnici bodo sodelovali ugledni [vabljeni predavatelji](#) z zanimivimi predavanji s področja fotonske integracije in kvantnih tehnologij.
Udeležba na konferenci in delavnici brez lastne predavitve je brezplačna.
Potrebna je predhodna [registracija](#).
Vabljeni k udeležbi!

Dogodki:

- Tečaj: [DelftX: The Hardware of a Quantum Computer](#)
25. avgust 2026, on-line
Spoznajte kako je kvantni računalnik zgrajen na strojni ravni ter kako deluje njegovo upravljanje in nadzor. Cilj tečaja je udeležencem približati najnovejši razvoj na področju kvantnih tehnologij in jih pripraviti na prehod v dobo kvantnega procesiranja informacij. Tečaj so pripravili strokovnjaki raziskovalnega centra QuTech na Tehniški univerzi v Delftu (TU Delft). Tečaj poteka on-line preko platforme edX. Za opravljen tečaj pridobite certifikat.
Na tečaj se je potrebno prijaviti – [tukaj](#).
- Tečaj: [Multiphysics Simulations of Electronic and Power Devices](#)
1. september 2026, Bratislava, Slovaška
Tečaj predstavlja uvod v večfizikalne simulacije elektronskih in močnostnih komponent z uporabo programske opreme COMSOL Multiphysics. Udeleženci bodo spoznali električno, toplotno in mehansko modeliranje,

povezane elektro-termo-mehanske simulacije, pripravo simulacijskih modelov, določanje robnih pogojev, mreženje (meshing) ter analizo in interpretacijo rezultatov simulacij.

Udeležba je brezplačna.

Na tečaj se je potrebno prijaviti – [tukaj](#)

- Konferenca: [FIRST by FMD Fast Innovation through Research in Semiconductor Technologies](#)

30. september – 1. oktober, Berlin, Nemčija

FIRST by FMD je evropska konferenca, namenjena predstavitvi trendov, razvojnih usmeritev in strateških prioritet na področju polprevodniških tehnologij.

Program konference vključuje vpogled v nastajajoče tehnologije, industrijske razvojne načrte ter prihodnji razvoj raziskovalne in tehnološke infrastrukture v okviru EU Chips Act in nemške Hightech Agende. Poseben poudarek bo namenjen tudi pilotni liniji [APECS](#), ki podpira razvoj naprednih tehnologij pakiranja, arhitektur na osnovi čipletov ter heterogene integracije.

Na dogodek se je potrebno registrirati - [tukaj](#).

- Konferenca: [ASDAM 2026 \(16th International Conference on Advanced Semiconductor](#)

[Devices and Microsystems\)](#)

7.–9. oktober 2026, Bratislava, Slovaška

16. mednarodna konferenca o naprednih polprevodniških napravah in mikrosistemih namenjena predstavitvi najnovejših rezultatov raziskav in razvoja na področju novih polprevodniških naprav in mikrosistemov.

Konferenca bo združila vodilne strokovnjake z raziskovalnih inštitutov, univerz in podjetij, ki delujejo na področju razvoja naprednih polprevodniških tehnologij in mikrosistemov.

Več informacij in registracija – [tukaj](#).

- Usposabljanje: [FAMES ACADEMY: Ferrite Circulators: Theory, Design and Simulation](#)

12. October 2026, Linz, Austria

Izobraževanje ponuja celovit pregled teoretičnih osnov in praktičnih vidikov delovanja feritnih cirkulatorjev. Program se začne s podrobno predstavitvijo magnetnih lastnosti, ki določajo njihovo delovanje, nadaljuje z analizo ključnih zmogljivostnih značilnosti in njihovega pomena za načrtovanje radiofrekvenčnih (RF) sistemov ter predstavi najpogostejše pristope k načrtovanju, tipične inženirske izzive in primer simulacije za ponazoritev osnovnih konceptov.

Udeleženci bodo imeli tudi priložnost za praktično delo s programsko opremo ANSYS HFSS, kjer bodo pridobili izkušnje s simulacijo struktur feritnih cirkulatorjev ter bolje spoznali postopke njihovega modeliranja. Poleg tega bo predstavljena tudi merilna oprema in pričakovani rezultati meritev, kar bo omogočilo primerjavo med teoretičnimi napovedmi in eksperimentalnimi rezultati.

Registracija na povezavi – [tukaj](#).

Razpisi:

Kljub zelo kratkim rokom za prijavo na spodnje razpise vam jih pošiljamo v vednost, morda vam vseeno koristijo.

- Razpis: [HORIZON-Chips-JU-2026-FT3-IA \(IA Resilience call reinforcing Europe's strenght in health\)](#)

Razpis podpira razvoj naprednih rešitev za zdravstvo, s poudarkom na naprednem medicinskem slikanju, oskrbi pacientov na domu ter

visokozmogljivih medicinskih instrumentih.

To področje razpisa spodbuja sodelovanje različnih deležnikov iz ekosistemov elektronike in zdravstva – od ponudnikov tehnologij, industrije in raziskovalcev do zdravnikov, zdravstvenih delavcev, oskrbovalcev ter pacientov. Cilj je razvoj inovativnih rešitev za zdravstvo, ki podpirajo medicinske raziskave in razvoj, preventivo, hitrejše okrevanje ter personalizirano zdravljenje v skladu z načeli medicine P4 (prediktivna, preventivna, personalizirana in participativna medicina).

Celoten opis razpisa je na voljo v dokumentu na [povezavi](#).

Okvirni proračun EU: 20 milijonov EUR

Rok za prijavo: 16. september 2026

- Razpis: [HORIZON-Chips-JU-2026-FT1-IA \(IA Resilience call reinforcing Europe's strength in power electronics\)](#)

Razpis za krepitev evropskih zmogljivosti na področju močnostne elektronike, namenjen povečanju proizvodnje polprevodniških naprav na 300-milimetrskih rezinah ter uvajanju agilnih pristopov k načrtovanju čipov. Celoten opis razpisa je na voljo v dokumentu na [povezavi](#).

Kvirni proračun EU: 40 milijonov EUR

Rok za prijavo: 16. september 2026

- Razpis: [DIGITAL-JU-CHIPS-2026-AI1-SG \(AI chip demonstrators for EU compute infrastructure\)](#)

Prvi razpis v okviru sklopa A pobude »AI chips and systems for EU compute infrastructure« je namenjen razvoju demonstratorjev čipov za umetno inteligenco. Cilj razpisa je podpreti vodilne evropske razvijalce čipov pri predstavitvi delujočih silicijevih rešitev, pripravljenih za vključitev v evropsko računalniško infrastrukturo.

Celoten opis razpisa je na voljo v dokumentu na [povezavi](#).

Okvirni proračun EU: 10 milijonov EUR

Rok za prijavo: 23. september 2026

- Razpis: [DIGITAL-JU-CHIPS-2026-SKILLS-HoE-SG \(Skills Hubs of Excellence\)](#)

Razpis podpira vzpostavitev dolgoročnih centrov odličnosti za univerzitetno in doktorsko izobraževanje na specializiranih področjih, kot sta načrtovanje in proizvodnja čipov.

Celoten opis razpisa na [povezavi](#).

Okvirni proračun EU: 20 milijonov EUR

Rok za prijavo: 24. september 2026

- Razpis: [DIGITAL-JU-CHIPS-2026-SKILLS-SCD-CSA \(Stimulation of Chip Design\)](#)

Razpis je namenjen zmanjševanju ovir za vstop na področje načrtovanja čipov z izboljšanjem dostopa do praktičnega izobraževanja, pridobivanja izkušenj pri načrtovanju čipov ter izobraževalnih izdelav testnih čipov (education tape-outs). Cilj razpisa je povečati privlačnost polprevodniškega sektorja, spodbuditi mlade k izbiri kariere na tem področju ter podpreti prekvalifikacijo in nadgradnjo znanj obstoječe delovne sile za potrebe novih tehnoloških izzivov.

Celoten opis razpisa na [povezavi](#).

Okvirni proračun EU: 15 milijonov EUR

Rok za prijavo: 24. september 2026

Novice:

- [China begins making homegrown DUV chipmaking tools, The Information reports](#)

Kitajska je začela proizvodnjo doma razvitih imerzijskih DUV (globoka

ultravijolična litografija) litografskih sistemov, ki predstavljajo eno ključnih tehnologij za izdelavo polprevodnikov in na katerih trgu že vrsto let prevladuje nizozemsko podjetje ASML. Prve naprave naj bi bile še letos dobavljene vodilnim kitajskim proizvajalcem čipov, med njimi podjetjem Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Hua Hong Semiconductor in ChangXin Memory Technologies.

- **[US to award GlobalFoundries \\$300 million to develop faster AI chip links](#)**

Podjetje GlobalFoundries je v sredo sporočilo, da mu bo ameriška vlada dodelila 300 milijonov ameriških dolarjev v okviru zakona CHIPS Act za okrepitev raziskav in razvoja na področju silicijeve fotonike, s katero želijo omogočiti učinkovitejše podatkovne centre za umetno inteligenco.

- **[Seoul Researchers Design Programmable Photonic Chip That Rewrites Optical Delay On the Fly](#)**

Skupna raziskovalna skupina Univerze v Seulu je predstavila recenzirano zasnovo programirljivega fotonskega integriranega vezja, ki omogoča zaustavljanje, preoblikovanje in preusmerjanje optičnih signalov izključno s programsko opremo, brez kakršnih koli sprememb strojne opreme. Če bo zasnova uspešno prenesena iz simulacij v dejansko izdelavo na osnovi silicijevega nitrida, bi lahko pomembno prispevala k odpravi sinhronizacijskih ozkih grl, ki trenutno omejujejo širšo uporabo optičnega računalništva v podatkovnih centrih za umetno inteligenco.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,

ekipa KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran: <https://cc-chip.si/>



Financira
Evropska unija



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljali na prejetje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

